

第 2 回 STAMP ワークショップ発表概要

タイトル

国際安全規格における STAMP/STPA 適用可能性の考察

Prospect for availability of STAMP/STPA as safety analysis in international safety standards

著者・発表者

東芝 余宮 尚志、ジェーエフピー 中村 洋

Toshiba Corporation Hisashi YOMIYA, JFP, Inc. Hiroshi NAKAMURA

概要

IEC 61508, ISO 26262 など、安全に関わる様々な国際規格では、製品の安全性を評価するための解析を、製品の開発工程に応じて複数回行うことを想定している。これら国際安全規格では、安全解析のための推奨技法が示されていることもあるが、実際の多くの開発では従来からの解析手法である FMEA, FTA, HAZOP が用いられている。

この発表では、

- (1) 従来からの解析手法と STAMP/STPA の特徴、及びそれらの違い、
 - (2) 国際安全規格における安全解析の目的・手順と STAMP/STPA の適用性
- などについて整理する。

そして STAMP/STPA は製品の開発工程における最上流である(安全のための)概念設計に最適であり、開発工程の下流では従来からの解析手法を用いるなど、解析手法としてこれらが相互補完的な関係にあることを説明する。

さらに国際安全規格がスコープとする安全性の評価対象を広げることが期待できるなど、STAMP/STPA を適用することによる有益性が示唆されていることについて、規格の解釈も踏まえ、いくつかの公開情報からの調査結果を紹介する。

本発表では、IEC 61508, ISO 26262, ISO 14121, ISO 12100 など、国際安全規格における安全解析の概要や考え方、公開情報を整理して説明するが、国際安全規格の詳説や STAMP/STPA の適用事例は含まない。

キーワード

- (1) STAMP/STPA
- (2) 安全解析
- (3) 国際安全規格

(4) ISO 26262

(5) 開発工程